

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公開番号】特開2011-75313(P2011-75313A)

【公開日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【年通号数】公開・登録公報2011-015

【出願番号】特願2009-224929(P2009-224929)

【国際特許分類】

G 01 R 31/26 (2006.01)

H 01 R 33/76 (2006.01)

【F I】

G 01 R 31/26 J

H 01 R 33/76 505 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月28日(2012.8.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板に形成された貫通孔に摩擦力によって保持される複数の導電性のコンタクトピンと、を有し、

前記基板は、

基材と、

前記基材に積層され、該基材よりも高い誘電率を有する少なくとも1つの層状誘電体と、

前記基材に積層され、前記層状誘電体の両側に形成された導電層とを有し、

前記複数のコンタクトピンの少なくとも1つは前記導電層のいずれか1つに電気的に接続されている、ICデバイス検査用ソケット。

【請求項2】

前記基板の前記貫通孔の内表面は導電性材料が形成され、該導電性材料が前記導電層の少なくとも1つに導通接続される、請求項1に記載のICデバイス検査用ソケット。

【請求項3】

前記導電層は電源層及びグラウンド層を有し、

前記複数のコンタクトピンは、

前記電源層に電気的に接続される電源ピンと、

前記グラウンド層に接続されるグラウンドピンと、

前記電源層及び前記グラウンド層のいずれにも接続されない信号ピンとを含む、請求項1又は2に記載のICデバイス検査用ソケット。